

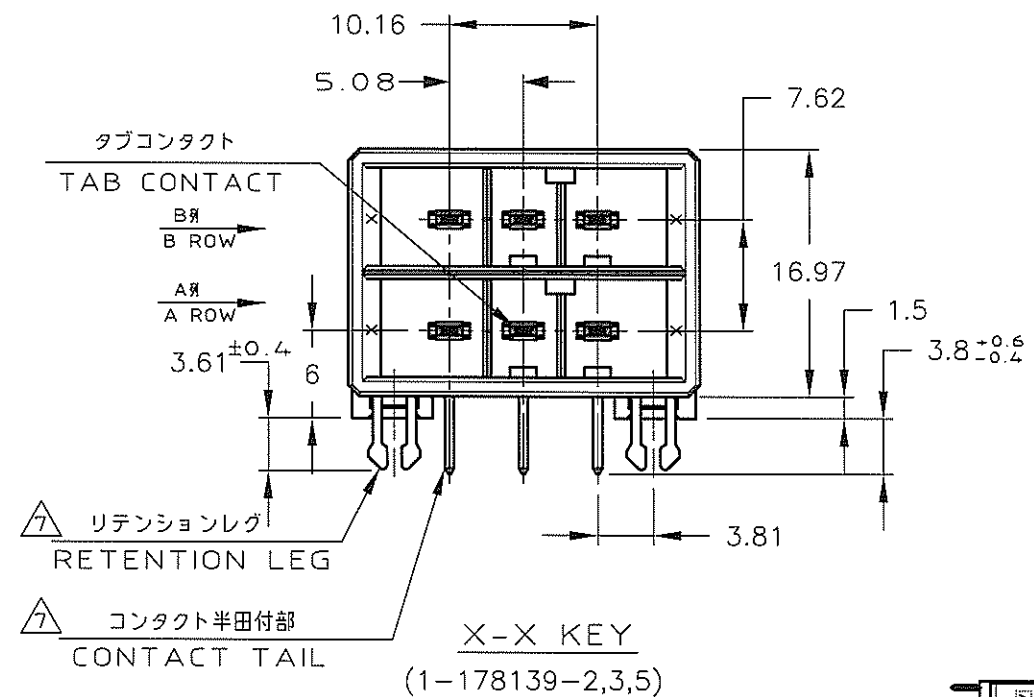
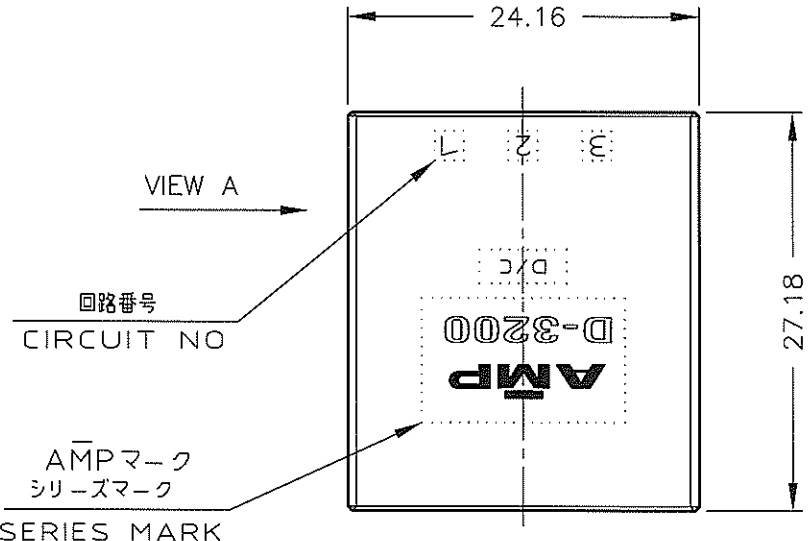
NUMBER 178139

3rd ANGLE PROJECTION

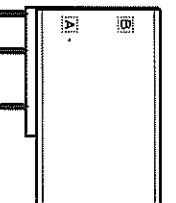
METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

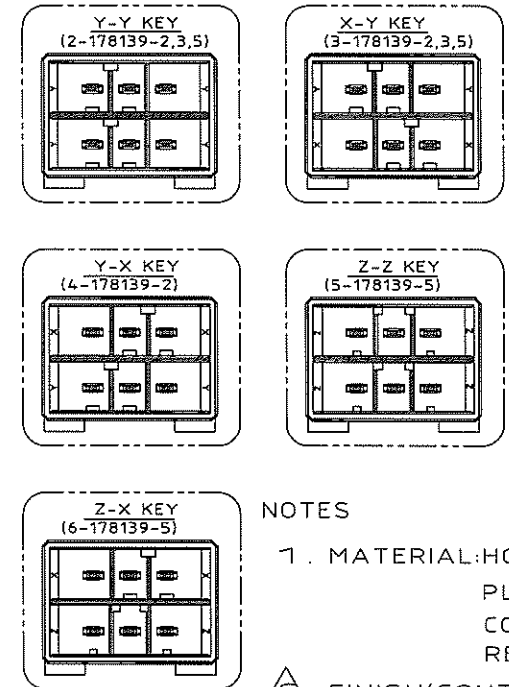
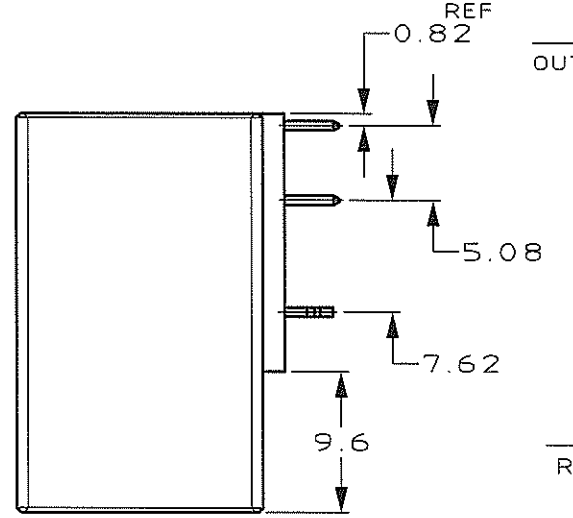
PRINT DIST



△ 4	△ 3	1,2,3,5,6-178139-5
△ 7	△ 3	1,2,3-178139-3
△ 7	△ 2	1,2,3,4-178139-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

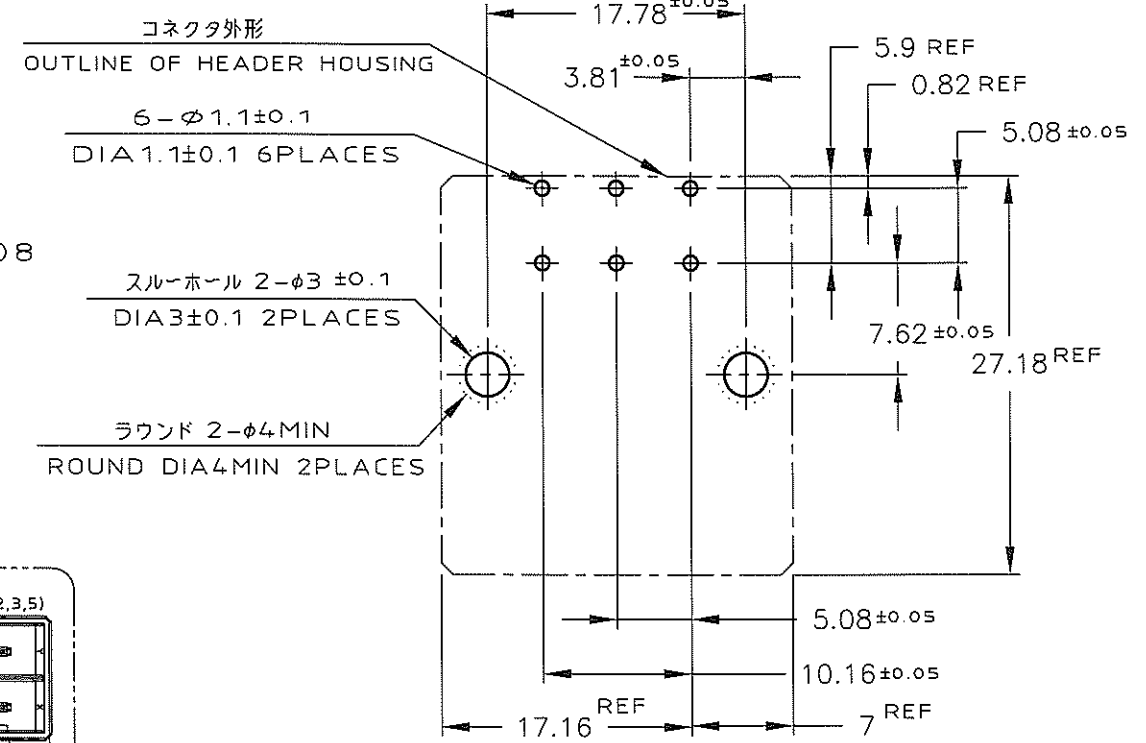


VIEW A
(SCALE: 1:1)



NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- PRODUCT SPEC: 108-5349
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエスチル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
- 製品規格: 108-5349
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

								 TE Connectivity							
				WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME 6 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3200							
				mm ² (AWG -)		- mmφ									
				MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10±F : ±0.3 100±F 300±F : ±0.4 300±F 1000±F : ±0.4, 5 A 度 : ±3'							
				DR. 20/MAR/'95 K.IKEDA		DE. 20/MAR/'95 K.IKEDA									
E3	REVISED PER ECO-11-005030			RK	HMR	14APR 11	C-178139								
LTR	REVISION RECORD			DR	CHK	DATE	CHK. 23/MAR/'95 S.MANABE	APP. 23/MAR/'95 S.MANABE		SIZE A3	LOC J	NUMBER	SCALE 2-1	REV. E3	SHEET 1 OF 1